

CERAMIC HEATER

Patent Number:

JP11317283

Publication date:

1999-11-16

Inventor(s):

OKUDA NORIO

Applicant(s):

KYOCERA CORP

Requested Patent:

□ JP11317283

Application Number: JP19980122588 19980506

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B3/18; C23C14/24; C23C16/44; H01L21/324; H01L21/68

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To uniformly heat by burying a heating pattern in which a resistance heating group made of a plurality of wire heaters connected in parallel is formed in the specified portion in a ceramic body.

SOLUTION: A heating element 4 having a heating pattern S of a plurality of resistance heating groups q1 -q24 made of, for example, seven wire heaters 5 connected in parallel is buried in a disc ceramic body which is used in a ceramic heater of a film forming device or an etching device of a semiconductor wafer and has a power supply terminal 6 on the lower surface. They are continuously connected and formed almost concentrically or spirally. In the resistance heating groups q1 -q24, by cutting at least one of the wire heaters 5 so that each resistance value becomes almost the same value, the dispersion of temperatures on the placing surface to support a body-to-be-heated is reduced to ± 1% or less. A ceramic body made mainly of boron nitride or aluminum nitride has high heat conductivity and corrosion resistance to halogen gas. The heating element 4 is formed in screen printing of conductive paste of high melting point metal for example.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-317283

(43)公開日 平成11年(1999)11月16日

(51) Int.Cl.*		設別記号	FI			
H05B	3/18		H05B	3/18		
C 2 3 C	14/24		C 2 3 C	14/24		Ļ
	16/44			16/44		В
H01L	21/324		H01L	21/324	. 1	K
	21/68			21/68]	N
			審查部		請求項の数1	OL (全 7 頁)
(21)出願番号]	特顏平10-122588	(71) 出願		633 株式会社	
(22) 出顧日		平成10年(1998) 5月6日	(72)発明	者 奥田 鹿児島	波男	田島羽殿町6番地 1番1号 京セラ株 内

(54) 【発明の名称】 セラミックヒータ

(57)【要約】

【課題】大型でかつ高温用のセラミックヒータ1であっ ても載置面3の温度バラツキを±1%以下に均熱化でき るようにする。

【解決手段】並列接続された2本以上の線状発熱体5か らなる抵抗発熱群 q,, q,, q,, · · · 同士を連続 的に接続した発熱パターンSをセラミック体2中に埋設 してセラミックヒータ1を構成する。



【特許請求の範囲】

(請求項1)並列接続された2本以上の線状発熱体から なる抵抗発熱群を所要箇所に形成した発熱パターンをセ ラミック体中に埋設してなるセラミックヒータ。

1

(発明の詳細な説明)

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セラミックヒータ に関するものであり、特に、CVD、PVD、スパッタ リングなどの成膜装置やエッチング装置に用いられるセ クヒータとして好適なものである。

[0002]

【従来の技術】従来、CVD、PVD、スパッタリング などの成膜装置やエッチング装置には、半導体ウェハ等 の被加熱物を支持しながら所定の処理温度に加熱するた めにセラミックヒータが使用されている。

【0003】 この種のセラミックヒータは、図4(a) (b) に示すように、円盤状をしたセラミック体12か らなり、該セラミック体12中には例えば図5に示すよ うな1本の線状発熱体15からなる発熱パターンRを埋 20 設するとともに、上記セラミック体12の上面を被加熱 物の載置面13としたものがあった。なお、16は上記 セラミック体12中に埋設されている線状発熱体15へ **通電するための給電端子である。**

【0004】また、このようなセラミックヒータ11 は、セラミックグリーンシート上に導体ペーストを印刷 により図5に示すような発熱パターンRに敷設し、該発 熱パターンRを覆うように別のセラミックグリーンシー トを積層してグリーンシート積層体を形成したあと焼成 することにより発熱体15を埋設してなるセラミック体 30 12を製作し、該セラミック体12の一方の主面に研磨 加工等を施して載置面13を形成するとともに、他方の 主面に発熱体15と連通する凹部を設け、該凹部に給電 端子16を接合することにより製作したものがあった

(実開平2-56443号公報参照)。

[0005]

(発明が解決しようとする課題) ところで、近年、ウエ ハサイズが大きくなり、当初その直径が6インチであっ たものが8インチ、さらには12インチと年々大きくな っており、大型のウエハサイズに対応したセラミックヒ 40 ータ11が要求されている。また、処理温度も年々高く なり、当初400℃程度であったものが550~850 ℃の髙温が要求されるようになり、さらにはセラミック ヒータ1の戧置面における温度バラツキ(平均温度に対 する最低温度と最高温度との差)を±1%以下と、高度 な均熱性が要求されていた。

【0006】しかしながら、前述した製法により図5に 示すような発熱パターンRを埋設してなるセラミックヒ ータ11では、このような特性を満足することができな かった。

【0007】即ち、セラミックグリーンシート上に発熱 体14をなす導体ペーストを印刷する工程において、印 刷機における精度の問題から印刷パラツキを小さくする には限界があり、この印刷バラツキによって発熱体14 の抵抗値が部分的にはらつくことから載置面13の温度 分布をさらに均一化することは難しくなっていた。

2

【0008】特に、載置面13の温度分布は発熱温度が 高くなればなるほど、また、セラミックヒータ11の大 きさが大きくなればなるほど均熱性が悪くなるといった ラミックヒータ、その中でも半導体製造装置用セラミッ 10 傾向があり、例えば発熱温度400℃における温度分布 が±1%であったセラミックヒータ11の発熱温度を8 00℃にまで上げるとその温度バラッキが±3%程度に まで悪化するというように、従来のセラミックヒーター 1では均熱化の要求を満足することが難しかった。

[0009]

【課題を解決するための手段】そこで、本発明は上記課 題に鑑み、並列接続された2本以上の線状発熱体からな る抵抗発熱群を所要箇所に形成した発熱パターンをセラ ミック体中に埋設してセラミックヒータを構成したもの である。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 説明する。図l(a)は本発明のセラミックヒータを示 す斜視図、(b)は(a)のX-X線断面図、図2は図 1のセラミックヒータに埋設する発熱パターンの一例を 示す平面図である。

【0011】図1に示すセラミックヒータ1は、発熱体 4を埋設してなる円盤状をしたセラミック体2からな り、該セラミック体2の上面を半導体ウエハ等の被加熱 物を支持する載置面3としたものであり、上記セラミッ ク体2の下面には上記発熱体4に通電するための給電端 子6を接合してある。

【0012】上記セラミック体2中に埋設する発熱体4 の発熱パターンとしては、例えば図2に示すような、並 列接続された7本の線状発熱体5からなる複数個の抵抗 発熱群 q 1 . q 1 . q 1 . · · · 同士を連続的に接続 し、略同心円状に構成したものであり、このように略同 心円状とすることで載置面3の温度分布をより均一にす るととができる。なお、発熱パターンSの形状は図2に 示したものだけに限定されるものではなく、渦巻き状や **梅歯状をしたものなどどのような形状をしたものであっ** ても構わない。また、図2では抵抗発熱群 q,, q,, q,,・・・でとの線状発熱体5の数を7本とした例を 示したが、少なくとも2本以上であれば良い。

【0013】そして、上記発熱パターンSを構成する各 抵抗発熱群 q , , q , , ・・・においては、抵抗 発熱群 q 1 , q 2 , q 1 , · · · · どとに必要に応じて各 抵抗発熱群 Q、、 Q、、 Q、、・・・を構成する線状発 熱体5の少なくとも1本以上を切断し、各抵抗発熱群 q

うに調整してある。

【0014】即ち、載置面3の温度分布は発熱パターン Sを構成する線状発熱体5の抵抗値と密接な関係があ り、各抵抗発熱群 q、、 q、、 q、、・・・でとの抵抗 値にばらつきがあると、載置面3の温度分布を均一にす ることができないのであるが、本発明では各抵抗発熱群 q、 q、 q、、・・が並列接続された複数本の線 状発熱体5からなるため、その切断する本数を調整する ことにより各抵抗発熱群 q、、 q、、 q、、・・の抵 抗値を容易に調整することができる。

【0015】その為、このセラミックヒータ1を発熱さ せれば、 載置面3の温度分布を極めて均一にすることが できるため、被加熱物を均一に加熱することができる。 【0016】このようなセラミック体2を構成する材質 としては、アルミナ、窒化珪素、窒化砌累、窒化アルミ ニウム等を主成分として含むセラミックスを用いること ができ、これらの中でも高熱伝導率を有するとともに、 成膜装置やエッチング装置等で使用されているハロゲン 系の腐食性ガスに対して優れた耐蝕性を有する窒化硼素 や窒化アルミニウムを主成分として含むセラミックスを 20 用いることが好ましい。特に、窒化アルミニウムの含有 量が99.8重量%以上の高純度窒化アルミニウムセラ ミックスや窒化アルミニウム含有量が91~99重量% でかつY, O,やErなどの希土類元素の酸化物を1~ 9重量%の範囲で含む窒化アルミニウムセラミックスを 用いることが望ましい。

【0017】また、上記セラミック体2中に埋設する発 熱体4を構成する材質としては、タングステン、モリブ デン、レニュウム等の高融点金属やこれらの合金、ある いは周期律表第4a、5a、6a族元素の炭化物や窒化 30 物を用いることができる。

【0018】次に、図1に示すセラミックヒータ1の製造方法について説明する。

【0019】まず、各種セラミック原料に対して溶媒やバインダー等を添加混練して泥漿を作製し、ドクターブレード法等のテーブ成型法にてセラミックグリーンシートを複数枚形成する。このうち、数枚のセラミックグリーンシートを積み重ねた上に、導体ペーストをスクリーン印刷機等にて図2に示す発熱バターンSに敷設する。即ち、並列接続された7本の線状発熱体5からなる複数 40 個の抵抗発熱群 q., q., q., ···同士を連続的に接続した略同心円状とする。

【0020】この時、スクリーン印刷機の精度の問題から各線状発熱体5には厚みばらつきがあるが、本発明は各抵抗発熱群q、、q、、q、、・・・を構成する線状発熱体5の断面積をそれぞれ測定し、例えば、同一円周上にある各抵抗発熱群q、、q、、q、、・・・でとの断面積の合計を算出し、その値の最も小さい抵抗発熱群を基準とし、この基準となる抵抗発熱群に対して断面積が大きすぎる抵抗発熱群については線状発熱体5を切断 50

して、各抵抗発熱群 q、, q, , q, , · · · · Cとの抵抗値がほぼ一致するように調整する。

【0021】ただし、各抵抗発熱群 q, , q, , q, , · · · を構成する線状発熱体 5 の合計断面積に対して 3 0%以上切断すると、局部的にその抵抗発熱群 q, , q, , q, , · · · · の抵抗値が高くなりすぎ、載置面 3 の均熱性を阻害することになるため、各抵抗発熱群 q, , q, , · · · · の線状発熱体 5 を切断する場合は各抵抗発熱群 q, , q, , · · · · を構成する線状発熱体 5 の合計断面積に対して 3 0%未満とすることが必要である。

【0022】また、図2に示す発熱パターンSについては同一円周上に位置する抵抗発熱群ごとに抵抗値を調整した例を示したが、発熱パターンSを構成する全ての抵抗発熱群の中でも最も断面積の小さな抵抗発熱群を基準とし、この基準となる抵抗発熱群に応じて他の抵抗発熱群(1, q1, q1, ···· を構成する線状発熱体5を切断し、全ての抵抗発熱群(1, q1, q1, ··· の抵抗値がほぼ一致するように調整しても良い。

(0023)しかるのち、上記発熱パターンSを覆うように残りのセラミックグリーンシートを積層してグリーンシート積層体を形成し、このグリーンシート積層体を各種セラミックス原料を焼結させることができる温度にて焼成することにより発熱パターンSを埋設してなるセラミック体2を製作し、得られたセラミック体2の一方の主面に研磨加工等を施して載置面3を形成するとともに、セラミック体2の他方の主面に発熱体4まで貫通する凹部を穿設し、該凹部に給電端子6をロウ付け等の手段によって接合すれば良い。

【0024】かくして得られたセラミックヒータ1を発熱させれば、発熱パターンSを構成する各抵抗発熱群 q 1 . q 1 . q 2 . o . o . o . o . u . o . u . o . c と から載置面3の温度パラツキを±1%以下に均熱化する ことができる。

【0025】なお、発熱パターンの構造としては、発熱パターンの全体が抵抗発熱群 q., q., q,, ···· により連続的に構成された例を示したが、本発明においては必ずしも発熱パターンの全体が抵抗発熱群 q., q,,····により連続的に構成されている必要はなく、発熱パターンの所要箇所に抵抗発熱群 q.,

Q. . Q. . · · · が連続的に形成されていれば良い。例えば、スクリーン印刷によるバラツキが殆どない部分がある場合には、図3に示すように印刷バラツキのない部分を1本の線状発熱体7とし、印刷バラツキのある部分を並列接続された2本以上の線状発熱体5からなる抵抗発熱群q. . Q. . Q. . · · · · により構成することができる。この発熱バターンの場合、線状発熱体7の断面積は、各抵抗発熱群q. . Q. . Q. . · · · · を構成する線状発熱体5の合計断面積より小さくしておき、線状発熱体7の断面積を基準として、各抵抗発熱群q. .

6

(4)

q., q,, · · · · の線状発熱体5を切断して断面積が ほぼ一致するように調整すれば良い。

5

[0026] (実施例)以下、本発明の具体例について 説明する。

【0028】次に、上記発熱パターンSを敷設したグリーンシートの積層体をX-Yテーブル上に載置し、各抵抗発熱群 q、 q , q , · · · を構成する線状発熱体5の断面積を測定した。この断面積の測定にあたっては、レーザー変位計を使用し、印刷されたタングステンペーストの高さを測定するとともに、X-Yテーブルか 20 らの移動距離をもとにタングステンペーストの線幅を求めて断面積を算出した。この結果は表1に示す通りである。なお、表1は最外周パターンの抵抗発熱群 q , q , q , · · · q , のみを示したものである。

(0029)そして、得られたデータより各抵抗発熱群 q1、q2、q3、・・・ごとに断面積を計算し、断面 積の最も小さい抵抗発熱群 q1,を基準として基準以外の 抵抗発熱群の断面積のばらつきを求めた。この結果、表 1 において基準となる抵抗発熱群 q1,の断面積に近いも のは抵抗発熱群 q6、 q7、 q1,で、基準となる抵抗発 30 熱群 q1,の断面積に対して非常に大きいものは抵抗発熱 群 q1、 q2、 q11、 q11、 q11、 q21であった。

【0030】そして、これらのデータより、各抵抗発熱群q,、q,、q,、・・・の抵抗値がほぼ一定になるように、基準となる抵抗発熱群q,,の断面積に対して非常に大きい抵抗発熱群q,、q,、q,,、q,,、q,,、e,、e構成する線状発熱体5の少なくとも1本以上を切断して抵抗値の調整を行った。その結果は表2に示す通りである。この結果、断面積のばらつきが最大2 40 6%であったものを5%にまで小さくすることができた。

【0031】 (表1]

				表-1失點	体の原面部						新田	1世份. 平方	,004
はお客様からいいの	20	1.62.40	200762	70004	70000	,,	701906	70000	7'073F	707689	7.03 673	1	3004911
	ŝ	6128	6128	5867	\$558	١.	4957	202	5295	245	5718	·	8176
~	25	5942	5942	5055	3		4818	4814	5148	5274	5.5		8105
n	5	11250	1059	10815	10324		9221	9187	9867	10146	10598		11275
~	8	22450	22533	21584	20362	19736	18504	18268	10155	19972	20746	21728	22720
.	ž	21460	21442	20899	19764		17810	17548	18810	19245	19979		21803
•	ă	22551	22661	21487	20500		18123	18174	10192	19949	21136		22953
~	8	23420	23003	22739	21330		18893	19012	20333	20841	22088		23971
プロンケルサ	100%	113202	112768	109046	103347		92326	92066	97784	100914	105690	Ĺ	115012
新画性のパラ2キ(%)		77	23	=	13	_	-	-	-	2	9	2	18
技列は様々ラーンNO	44	7.079/1	418.640.6	7077.915	-	7.09 817	llv	8/8/40,6		7.000	70.75.11	7007 514	3 De 9 6 sec
	28	8200	0100	5965	2894	5343	şğ	5084	540)	5475	5833	5017	280
~	20	2884	5983	1979		5217		4807		5295	5844	5819	6042
-	Ž	1150	11267	10921		9768		9242		10231	10622	11111	11646
•	50%	22550	22233	21469		19207		18097		19945	21050	21580	21736
•	Š	21400	21408	20347		18242		17330		19360	19826	20413	22041
•	ž	21589	21514	20759		18816		17790		119311	20129	20623	21824
	Š.	23540	23199	22840		20245		19029		21163	22121	22985	23669
7 07/1/1	200	112713	111774	108051	103300	90826		81439		100779	105425	108489	114218
配置性のヘックキ(名)		23	22	4	-	•	٩	•	-	2	36	5	1

o 【0032】 【表2】

8	
%である高純度窒化アルミニウムセラ	ź

%である高純度窒化アルミニウムセラミックスからなる ものであった。

(0034) しかるのち、上記セラミック体2の一方の主面を中心線平均租さ(Ra) 0.8 μm以下に研磨加工を施して載置面3を形成するとともに、上記セラミック体2の他方の主面にセラミック体2中に埋設する発熱体4に連通する凹部を設け、該凹部にFe-Co-Ni合金からなる給電端子6をロウ付け固定して窒化アルミニウムセラミックスからなるセラミックヒータ1を製作した。

【0035】そこで、抵抗発熱群 q1, q2, q3, · · · でとに表2のように抵抗調整した本発明のセラミックヒータ1と、従来例として図5に示す発熱パターンRを埋設してなるセラミックヒータ11を用意し、それぞれ800℃に発熱させて載置面3, 13の温度バラツキを測定したところ、従来のセラミックヒータは載置面13の温度バラツキが±10%もあったが、抵抗調整した本発明のセラミックヒータ1は載置面3の温度バラツキを±0.8%程度にまで抑えることができた。

20 [0036]

【発明の効果】以上のように、本発明によれば、並列接続された2本以上の線状発熱体からなる抵抗発熱群を所要箇所に形成した発熱パターンをセラミック体中に埋設してセラミックヒータを構成したことから、セラミック体中に発熱体を埋設する前に発熱パターンの抵抗値を容易に調整することができ、載置面の温度パラツキを±1%以下にまで均熱化することができる。

【図面の簡単な説明】

(図1] (a) は本発明の製法によるセラミックヒータ 30 を示す斜視図、(b)は(a)のX-X線断面図である

【図2】図1のセラミックヒータに埋設する発熱パターンの一例を示す平面図である。

【図3】発熱パターンの他の例を示す平面図である。

【図4】(a)は従来のセラミックヒータを示す斜視図、(b)は(a)のY-Y線断面図である。

【図5】図4のセラミックヒータに埋設する発熱バターンの一例を示す平面図である。

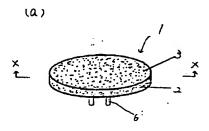
【符号の説明】

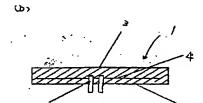
- 1, 11···セラミックヒータ 2, 12··・セラ ミック体
- 3. 13··· 载置面 4··· 発熱体 5. 15··· · 線状発熱体
- 6. 16···給電端子 q., q., q, . ···抵 抗発熱群
- S、R・・・発熱パターン

				夏一21パン	数の知識性	10 min 01					N III I	五年 中	2.90.
日子 MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN MAN	ž	7.02481	7,079.83	7,05983	2,000,80	7.070.5	7.0756	78797	20006	7.00.187	7.01/100	7,000	30460
- 1	Š	6219	8128	· 5887	5554	5289		5063	0	5487	5718	0	9(1)
~	Š	6942	2842	0	<u> </u>	0		4814	5146	5274	0	5691	A105
07	2	11250	11059	0	.	9784		0187	9857		, -		27611
₹ 1	5	۰.	22633	21584	20362	10738	_	18268	18165	19972	20746	21728	29720
	Š	21400	•	20699	19764	18333	17810	17548	16816	19245	18928	20639	21803
	Š	22551	22681	21487	20590	10800	_	18174	19182	19949	21138	21813	22859
7	ă	23420	23003	22739	21330	20058		19012	20333	20871	22084	22508	
Property I	200	90752	91326	92576	\$3024	92988	ľ	92000	97489	97,49	100	27770	3
TENDO 724(%)		-	0	-	2	0	-		-	1		10000	3
1000								-			ď	-	-
A THE WAY P-INO		7 0796/7	9	7 079 8/5	J'07 616	7.8000	707	7.29.07	5075.820	7.8.600 7	7.00.623	2,000,0	7.00-00-0
- •	á	\$200		٥.	5694	5343		5084	0 .:		583	5017	256
~	ν, ×	2884		5751	5459	0		4887	5228	5295		•	8043
-	ž	11450	•	•	•	9756		9242	9972	:		•	
-	Š	22550	•••	21489	20905	19207		18097	10501	10045	0.016	91600	300
'n	208	.0	21408	20347	19343	18242	_	17130	18835	OAL DI	19036	2002	2000
	Š	21689		20159	19703	10016		20071	18547	1991	20129	2000	2007
,	Š	23540	``	2284N	21791	20245	19320	19029	20289	21163	22121	22085	*7917
TILL THE	8	91313	90200	91105	82895	91610	٦	91439	92262	90548	88959	91499	90550
G 00 F 01 A 27 E (96)		٥	7	٥	2	0	•	0	-	7	5	-	1

【0033】そして、このように抵抗値の調整を行った 40 発熱パターンS上に残りのAINからなるセラミックグリーンシートを積層してグリーンシート積層体を形成し、該グリーンシート積層体を窒素雰囲気中にて1900~2100℃の焼成温度で1~数時間程度焼成することにより、発熱体4を埋設してなるセラミック体2を得た。なお、このセラミック体2の組成をICPにて測定したところ、窒化アルミニウムの含有量が99.8 重量

(図1)

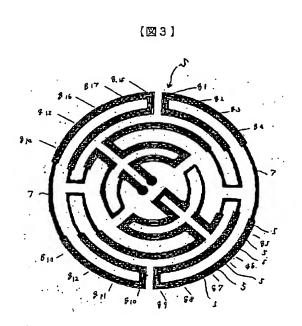


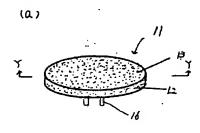


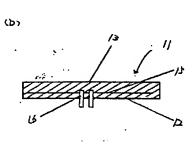
【図2】



【図4】







【図5】

